

スピネッチング装置用  
シリコンウェハエッチング液

# Siエッチシリーズ

スピネッチング装置用のシリコンウェハエッチング液。  
ウェハ裏面の鏡面化または粗面化処理に最適です。

## Siエッチシリーズ一覧

● 鏡面化処理液

**SiエッチE** Etch.rate : 25  $\mu\text{m}/\text{min}$

**SiエッチJ** Etch.rate : 8  $\mu\text{m}/\text{min}$

**SiエッチF** Etch.rate : 20  $\mu\text{m}/\text{min}$

● 鏡面仕上げ液

**MH-3** Etch.rate : 10  $\mu\text{m}/\text{min}$

● 粗面化処理液

**SiエッチD** Etch.rate : 2  $\mu\text{m}/\text{min}$

**SiエッチC** Etch.rate : 3  $\mu\text{m}/\text{min}$

## 処理例

